

## ◇ ◇ IEICE 先端セミナー新コース開講のお知らせ ◇ ◇

目まぐるしい技術革新が進む現代において、非専門分野のキーテクノロジーを自学自習するのは一般的に容易ではありません。当学会では、電子情報通信分野の第一人者から入門者の方々へ向けて、グローバルに話題となっている最新技術を分かりやすく講義した Webinar を制作しました。本セミナーの受講を通じて最新技術の要所を理解し、様々な社会課題を解決する人材が生まれることを期待しています。また、1コース全ての講義を受講し、設問をクリアできた受講生に対してはデジタルバッジを付与致します。現在、四つのコースを受講することができます。多くの皆様の受講をお待ちしています。

### 1. 【新コース】6G に向けた 3GPP の無線アクセスの標準化動向（2024 年 10 月開講）

ITU-R における 6G に関わる規格策定の枠組みに加え、WRC-27 に向けた 5G/6G 等で用いる周波数選定の動向を紹介した上で、3GPP における RAN（Radio Access Network）の標準仕様について、Release 18 を中心に、最新の技術内容及び動向を解説します。

第1回	Beyond 5G/6G 時代に向けた ITU-R 動向	今田論志（KDDI 株式会社）
第2回	3GPP Release 18 の RAN 標準化動向	武田一樹（ケアルコム）
第3回	3GPP における無線インタフェースへの AI/ML 標準化	山本哲矢（パナソニックホールディングス）
第4回	3GPP における NR サイドリンク標準化	鈴木翔一（シャープ株式会社）

### 2. 【新コース】次世代半導体の技術動向（2024 年 10 月開講）

最近の急速な発達をはじめとして現在の IT 産業を支えているのは半導体です。日本も TSMC やマイクロンの工場誘致、最先端半導体を開発する Rapidus の立ち上げなど半導体に関する大きなニュースが世情を賑わしています。本講義は、半導体とは何か、どのように開発するのか、アナログ、ロジック、メモリ、パワー半導体はどのように違うのか、日本の強みと弱みはどこか、からはじめて、最新デバイス技術、最新 AI チップに加え、新しいファブ技術であるマイクロファブまでを紹介します。

第1回	先端半導体の最前線	池田 誠（東京大学）
第2回	半導体製造プロセスの最前線	浜口智志（大阪大学）
第3回	ミニマルファブ最前線	原 史朗（産業技術総合研究所）
第4回	AI チップ開発の最先端	本村真人（東京工業大学（現・東京科学大学））

### 3. AI 社会実装の最先端と技術動向

社会や産業での AI を活用したサービスやシステムの社会実装が進み、人々の生活、働き方を大きく変えつつあります。AI のハードウェア・インフラから信頼できる AI に向けた解釈・説明技術、AI 倫理と社会、大規模言語モデルの最新技術動向まで AI の社会実装を支える技術の現状と課題、今後の展望を解説します。

第1回	AI ハードウェア・インフラの技術動向	中原啓貴（東京工業大学）
第2回	信頼できる AI に向けた機械学習モデルの解釈・説明技術	原 聡（大阪大学）
第3回	AI 倫理と社会	中川裕志（理化学研究所）
第4回	大規模言語モデルの最新技術動向	岡崎直観（東京工業大学（現・東京科学大学））

#### 4. 量子コンピュータと量子情報通信入門

従来のコンピュータと比べて桁違いの計算能力を持ち、AI 応用、新材料発見、エネルギーや物流の最適化、暗号セキュリティ等へ応用が期待されている量子コンピュータ・量子情報通信の基本的な仕組みを解説します。

第1回	量子コンピュータの基礎知識	藤井啓祐 (大阪大学)
第2回	量子コンピュータのプログラミング	藤井啓祐 (大阪大学)
第3回	量子コンピュータのハードウェア	阿部英介 (理化学研究所)
第4回	量子情報通信	東 浩司 (NTT 物性科学基礎研究所)

#### 受講料 (各コース共通)

会 員 (正員)	13,200 円 (税込)
非会員 (一般)	26,400 円 (税込)
会 員 (学生員)	3,300 円 (税込)
非会員 (学生)	4,950 円 (税込)

お申込みはこちら

[https://www.ieice.org/jpn\\_r/activities/advanced\\_seminar.html](https://www.ieice.org/jpn_r/activities/advanced_seminar.html)

問い合わせ先：電子情報通信学会会員サービス課 member@ieice.org

